

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2011年8月4日(04.08.2011)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2011/093142 A1

- (51) 国際特許分類:
C01B 33/18 (2006.01) *C08L 101/00* (2006.01)
C08K 9/06 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/050491
- (22) 国際出願日: 2011年1月14日(14.01.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-014016 2010年1月26日(26.01.2010) JP
特願 2010-178811 2010年8月9日(09.08.2010) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 堺化学工業株式会社(SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5908502 大阪府堺市堺区戎島町5丁2番地 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 松窪孝典(MATSUKUBO, Takanori) [JP/JP]; 〒5900985 大阪府堺市堺区戎島町5-1 堺化学工業株式会社内 Osaka (JP). 中川健一(NAKAGAWA, Ken-ichi) [JP/JP]; 〒5900985 大阪府堺市堺区戎島町5-1 堺化学工業株式会社内 Osaka (JP). 鈴木雅博(SUZUKI, Masahiro) [JP/JP]; 〒5900985 大阪府堺市堺区戎島町5-1 堺化学工業株式会社内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 八木敏安(YAGI, Toshiyasu); 〒5320011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目7-19 第7新大阪ビル602号 Osaka (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告(条約第21条(3))

(54) Title: SILICA PARTICLES, PROCESS FOR PRODUCTION OF SAME, AND RESIN COMPOSITION CONTAINING SAME

(54) 発明の名称: シリカ粒子とその製造方法、及びそれを含む樹脂組成物

(57) Abstract: Disclosed are: silica particles which have a sharp particle size distribution and a low water absorption rate and can be used suitably as a filler for a sealing resin composition; a process for producing the silica particles; and a resin composition comprising the silica particles and a resin. The silica particles have a water absorption rate of less than 1.0% when measured for 500 hours under the conditions of a temperature of 50°C and a humidity of 90% and the conditions of a temperature of 85°C and a humidity of 85%, a D90/D10 value of 3 or less, a true specific gravity of 2.1 g/cm³ or more, and an average particle diameter of 10 μm or less.

(57) 要約: 粒度分布がシャープで、かつ、吸水率が低く、封止用樹脂組成物の充填材として好適に使用することができるシリカ粒子、その製造方法、及び、このシリカ粒子と樹脂とからなる樹脂組成物を提供する。50°C—湿度90%及び85°C—湿度85%条件下において500時間での吸水率が1.0%未満であり、D90/D10が3以下であり、真比重が2.1 g/cm³以上であり、平均粒子径が10 μm以下であるシリカ粒子。



WO 2011/093142 A1